LAGENAUFBAU HDI (Standard)

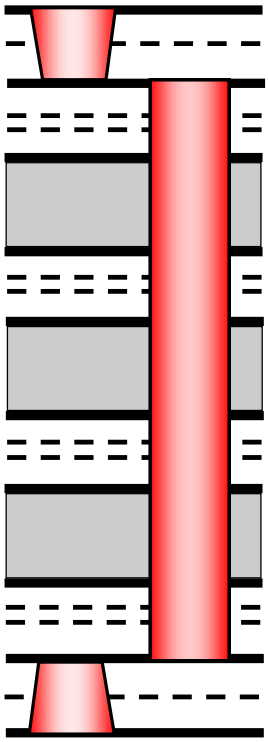
HDI10_1+8b+1_1,15_17.5

10 - Lagen

Kerne: 0,10 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 8B + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	12 µm		**35**	
					2 x 1080	**140**	
3	2			17.5 µm		**16**	
			0,100 mm			**100**	
4	3			17.5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
5	4			17.5 µm		**16**	
			0,100 mm			**100**	
6	5			17.5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
7	6			17.5 µm		**16**	
			0,100 mm			**100**	
8	7			17.5 µm		**16**	
					2 x 1080	**140**	
9	RSK1			12 µm		**35**	
					1 x 1080	**60**	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
					Gesamtdicke Material:	1158	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,15**	+/-	0,09	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,24	+/-	0,12	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,30	+/-	0,14	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	14+